

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 11 月 27 日 (27.11.2003)

PCT

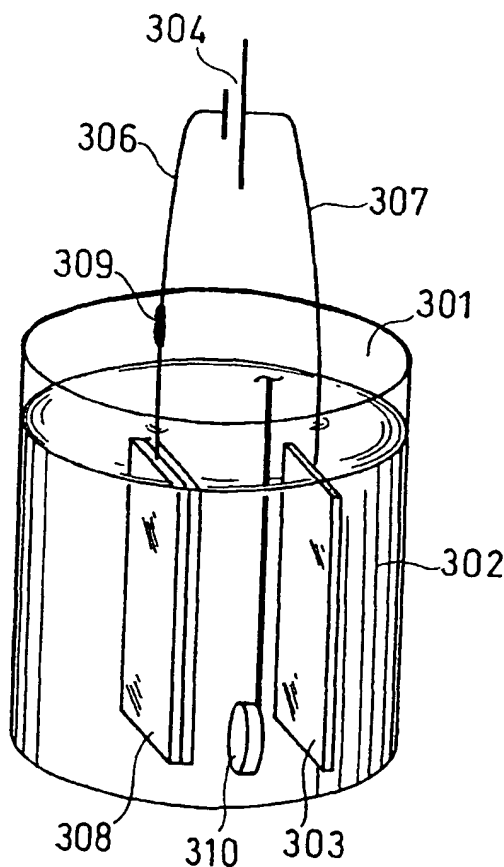
(10) 国際公開番号
WO 03/097317 A1

- (51) 国際特許分類: B29B 17/02, B09B 3/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP03/05312
- (22) 国際出願日: 2003 年 4 月 24 日 (24.04.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2002-142146 2002 年 5 月 16 日 (16.05.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (73) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 南野 哲郎 (NANNO, Tetsuo) [JP/JP]; 〒581-0013 大阪府 八尾市 山本町南 4-5-24 Osaka (JP). 和泉 陽一 (IZUMI, Yoichi) [JP/JP]; 〒583-0865 大阪府 羽曳野市 羽曳が丘西 1-6-62 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 石井 和郎, 外 (ISHII, Kazuo et al.); 〒541-0041 大阪府 大阪市 中央区北浜 2 丁目 3 番 6 号 北浜山本ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR RELEASING METAL-RESIN JOINT

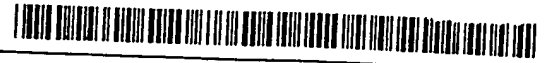
(54) 発明の名称: 金属-樹脂接合部の剥離方法および剥離装置



(57) Abstract: A method for releasing a metal-resin joint which comprises a step (1) of immersing an article having the metal-resin joint in an alkaline solution together with a counter electrode and a step (2) of applying a voltage between a metal part of the joint and a counter electrode so as for the metal part to have a potential being base against that of a standard hydrogen electrode for a predetermined time.

(57) 要約: (1) 金属-樹脂接合部を有する物体と、対極とを、アルカリ性の液中に浸漬する工程、(2) 前記接合部の金属部分と、前記対極との間に、前記金属部分の電位が標準水素電極に対して卑になるように、一定時間にわたり電圧を印加する工程、からなる金属-樹脂接合部の剥離方法。

WO 03/097317 A1



TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU,
ZA, ZM, ZW.

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。